附件3：

全国半导体行业优秀融资项目评选申请表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位基本情况 | 中文名称 |  | | 注册资金 |  |
| 英文名称 |  | | 邮 编 |  |
| 联系人&职务 |  | | E-mail |  |
| 电 话 |  | | 手 机 |  |
| 单位性质 | □国有 □股份制 □私营 □合资 □外企 □其它 | | | |
| 注册地址 |  | | | |
| 产品名称/系列/型号 | |  | | | |
| 产品类别 | |  | | | |
| 知识产权说明 | |  | | | |
| 产品销售额 | | 2021年销售额（万元） | 同类产品市场占有率 | | （占有率单位：％） |
| 上年度利税总额 | | 单位（万元） | 上年度研究开发经费投入 | | 单位（万元） |
| 是否已经融资 | | □是 □否 | 已融资情况说明 | | 投资人、各轮融资情况 |
| 期望融资金额 | | 单位（万元） | 期望融资形式及说明 | |  |
| 产品图片  （图片清晰度在300dpi以上，请在本表插入缩略图，高清图片可附件） | | | | | |
| 产品主要功能及主要技术参数  （500字以内） | | | | | |
| 该产品在何时何地曾获何种奖励  （请附获奖证书复印件，如无则填写“无”） | | | | | |
| 创始人简介及创业经历 | | | | | |
| 团队情况介绍 | | | | | |
| 产品经何组织鉴定及鉴定意见  （请附鉴定报告书或意见书等证明文件复印件，如无则填写“无”） | | | | | |
| 知识产权情况  （请附专利、软著、集成电路设计图所有权等证书复印件） | | | | | |
| 研究目标、关键技术和拟解决的产业关键问题  （请详细说明） | | | | | |
| 现有技术在产业的应用现状及其局限性  （请详细说明） | | | | | |
| 本颠覆性技术对有关产业的颠覆要点  （请详细说明） | | | | | |
| 项目研究内容、研究方法及技术路线  （请详细说明） | | | | | |
| 项目风险分析及对策  （请详细说明政策、技术、市场等方面风险及对策） | | | | | |
| 主要应用领域方向及主要客户  （主要客户需列举及合同金额） | | | | | |

**诚 信 承 诺 书**

本人以 公司 的身份郑重声明并承诺：本企业提供的基本情况、获奖情况等其他官方提供的一切资料及其数据内容真实有效；本知识产权没有争议；本产品没有引发过重大事故。如有提供的信息有造假成分，视为直接退出本次评选活动！

企业代表人（签名）

（企业公章）

年 月 日